

迈思泰克氮气真空回流焊TRV系列

产品名称	迈思泰克氮气真空回流焊TRV系列
公司名称	苏州迈思泰克精密设备有限公司
价格	11.00/件
规格参数	品牌:劲拓 型号:TRFV 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马安山社区万安路17号C栋208、苏州吴中区衡山路98号5号厂房一楼
联系电话	13302910083 13302910083

产品详情

TRV系列真空回流焊

型号：TRV系列[真空回流焊](#)

引入真空条件

利用压力差 溢出气泡

真空焊接工艺是在回流焊接过程中引入真空环境的一种回流焊接技术。在产品进入回流区的后段,制造一个真空环境,提升焊接质量。

熔融状态的焊点外部环境接近真空,由于焊点内的气泡从中溢出,大幅降低焊点缺陷性。

普通回流焊焊接时因为空气气压影响,焊锡中的气泡难以溢出,冷却后形成焊点空洞。

焊接时将熔融状态的盘置入负压真空中,利用压力差,从而减少空洞。

真空焊接效果对比

正常大气压下焊接气泡的发生率大概在25%左右。

在真空气压中焊接,气泡的发生率在1%-5%左右。

空洞率测试实例

一.真空回流焊主要特点：

1.

TRV系列真空回流焊

高效率、无空洞、低维护：配备真空选项的TRV回流焊能够有效解决焊接后出现的气孔，空洞和空隙等问题，当真空气压达到10mbar-5mbar时高可将空洞率降低到1%以下；真空压力和真空速率均可单独设置，并保存为曲线参数。这一集成化的解决方案使生产制程更加稳定、高效，避免空洞率过高导致PCB板重焊或报废，降低生产成本。

2. jingque的压力和温控曲线：

同标准回流焊一样，TRV系列真空回流焊

各个加热区之间具备隔热性，各个加热区的温度可以单独调节，确保实现灵活的温度曲线及焊接制程；开启真空制程时，压力在10mbar以下温度曲线依然能够达到所设定的值；可以借助腔体内部红外加热功能，真空腔体单元内的组件温度能够达到常规的标准设定，确保实现高效稳定的生产制程。

二.真空回流焊应用场景

二规格参数

外形尺寸	5520*1430*1530	5520*1660*1530	6300*1430*1530	6300*1660*1530	7050*1430*
颜色	计算机灰				
重量	2500KG	2900KG	2800KG	3200KG	3100KG
加热区个数	上8(1 IR)/下7		上10(1 IR)/下9		上12(1 IR)/
加热区长度	3110mm		3890mm		4640m
冷却区个数	上3/下3 (冷空气内循环式)				
排风量要求	10 m/ min x2 (通道)				
电气要求	AC, 380V 3 50/60Hz(选配:AC, 220V 3 50/60Hz)				
电源功率要求	67KW	67KW	83KW	83KW	105KW
启动功率	32KW	34KW	38KW	40KW	42KW